



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206162291 U

(45)授权公告日 2017.05.10

(21)申请号 201620912556.2

(22)申请日 2016.08.19

(73)专利权人 益德电子科技(杭州)有限公司
地址 310000 浙江省杭州市西湖区西园一
路16号5幢103室

(72)发明人 林换堂

(51)Int. Cl.
G06F 1/18(2006.01)

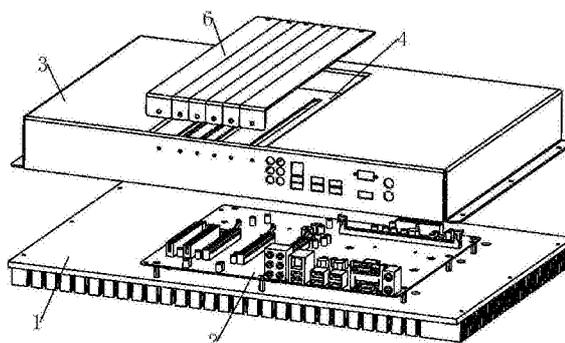
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

电脑主机箱

(57)摘要

本实用新型提供了一种电脑主机箱,包括:散热铝基板;箱盖,扣在散热铝基板的上方以在所述散热铝基板与所述箱盖之间形成主板安装空间;主板,安装在主板安装空间内,且主板的CPU与散热铝基板的上表面紧贴。本实用新型中的散热铝基板直接与主板的CPU连接,从而起到主动散热的作用,从而可使电脑在无噪音状态下运行,因此不需要使用风扇进行散热,相应地就不会产生风道吸入灰尘,因而,增强了主机的稳定性及延长使用寿命;同时散热铝基板又是机箱外壳的一部分,可以充分利用外部空间来协助电脑散热。



1. 一种电脑主机箱,其特征在于,包括:

散热铝基板(1);

箱盖(3),扣在所述散热铝基板(1)的上方以在所述散热铝基板(1)与所述箱盖(3)之间形成主板安装空间;

主板(2),安装在所述主板安装空间内,且所述主板(2)的CPU与所述散热铝基板(1)的上表面紧贴。

2. 根据权利要求1所述的电脑主机箱,其特征在于,所述箱盖(3)上形成有凹陷部(4),所述凹陷部(4)对应于所述主板(2)的扩展卡插槽(5)设置;

所述电脑主机箱还包括多个与所述箱盖(3)可拆卸地连接的扩展槽盖板(6),所述多个扩展槽盖板(6)安装在所述凹陷部(4)的位置。

3. 根据权利要求2所述的电脑主机箱,其特征在于,所述电脑主机箱还包括转接卡(7),所述转接卡(7)包括电路板和安装在所述电路板上的扩展槽(8),所述电路板沿竖直方向插在所述扩展卡插槽(5)上,所述扩展槽(8)沿水平方向安装在所述电路板上。

4. 根据权利要求3所述的电脑主机箱,其特征在于,所述电脑主机箱还包括扩展件(9),所述扩展件(9)的一端沿水平方向插入所述扩展槽(8)中。

电脑主机箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电脑配件领域,特别涉及一种电脑主机箱。

背景技术

[0002] 现有技术中的电脑CPU都是通过风扇来进行散热,不但有噪音且使用一段时间会有大量的灰尘吸入等,从而影响主机的稳定性和使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种电脑主机箱,以解决现有技术中的电脑主机箱有噪音、会因风扇吸入灰尘从而影响主机的稳定性和使用寿命的问题。

[0004] 为解决上述问题,作为本实用新型的一个方面,提供了一种电脑主机箱,包括:散热铝基板;箱盖,扣在散热铝基板的上方以在所述散热铝基板与所述箱盖之间形成主板安装空间;主板,安装在主板安装空间内,且主板的CPU与散热铝基板的上表面紧贴。

[0005] 优选地,箱盖上形成有凹陷部,凹陷部对应于主板的扩展卡插槽设置;电脑主机箱还包括多个与箱盖可拆卸地连接的扩展槽盖板,多个扩展槽盖板安装在凹陷部的位置。

[0006] 优选地,电脑主机箱还包括转接卡,转接卡包括电路板和安装在电路板上的扩展槽,电路板沿竖直方向插在扩展卡插槽上,扩展槽沿水平方向安装在电路板上。

[0007] 优选地,电脑主机箱还包括扩展件,扩展件的一端沿水平方向插入扩展槽中。

[0008] 本实用新型中的散热铝基板直接与主板的CPU连接,从而起到主动散热的作用,从而使电脑在无噪音状态下运行,因此不需要使用风扇进行散热,相应地就不会产生风道吸入灰尘,因而,增强了主机的稳定性及延长使用寿命;同时散热铝基板又是机箱外壳的一部分,可以充分利用外部空间来协助电脑散热。

附图说明

[0009] 图1示意性地示出了本实用新型的爆炸图;

[0010] 图2示意性地示出了扩展槽盖板处于部分安装时的结构示意图;

[0011] 图3示意性地示出了扩展槽盖板处于完全安装时的结构示意图;

[0012] 图4示意性地示出了扩展件的安装示意图。

[0013] 图中附图标记:1、散热铝基板;2、主板;3、箱盖;4、凹陷部;5、扩展卡插槽;6、扩展槽盖板;7、转接卡;8、扩展槽;9、扩展件。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

[0015] 如图1至图4所示,本实用新型提供了一种电脑主机箱,包括:散热铝基板1;箱盖3,扣在散热铝基板1的上方以在所述散热铝基板1与所述箱盖3之间形成主板安装空间;主板

2,安装在主板安装空间内,且主板2的CPU与散热铝基板1的上表面紧贴。

[0016] 本实用新型中的散热铝基板1直接与主板2的CPU连接,从而起到主动散热的作用,从而可使电脑在无噪音状态下运行,因此不需要使用风扇进行散热,相应地就不会产生风道吸入灰尘,因而,增强了主机的稳定性及延长使用寿命;同时散热铝基板1又是机箱外壳的一部分,可以充分利用外部空间来协助电脑散热。

[0017] 优选地,箱盖3上形成有凹陷部4,凹陷部4对应于主板2的扩展卡插槽5设置;电脑主机箱还包括多个与箱盖3可拆卸地连接的扩展槽盖板6,多个扩展槽盖板6安装在凹陷部4的位置。这样,当需要插入需要扩展卡的时候,只需要打开相应的扩展槽盖板6即可进行操作,具有灵活、简单、快速的特点,而不需要像当前市面上普通电脑机箱那样需要插入扩展件时要打开机箱来进行相应的操作,非常繁琐耗时。

[0018] 优选地,电脑主机箱还还包括转接卡7,转接卡7包括电路板和安装在电路板上的扩展槽8,电路板沿竖直方向插在扩展卡插槽5上,扩展槽8沿水平方向安装在电路板上。优选地,电脑主机箱还包括扩展件9,扩展件9的一端沿水平方向插入扩展槽8中。采用这种90度转角的转接卡7,使扩展件9(如显卡等设备)可以横着(平躺式)插入转接卡7后与主板连接。采用这样的设计同,不会因为插入扩展件而导致机箱的占用空间发生较大的变化。

[0019] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

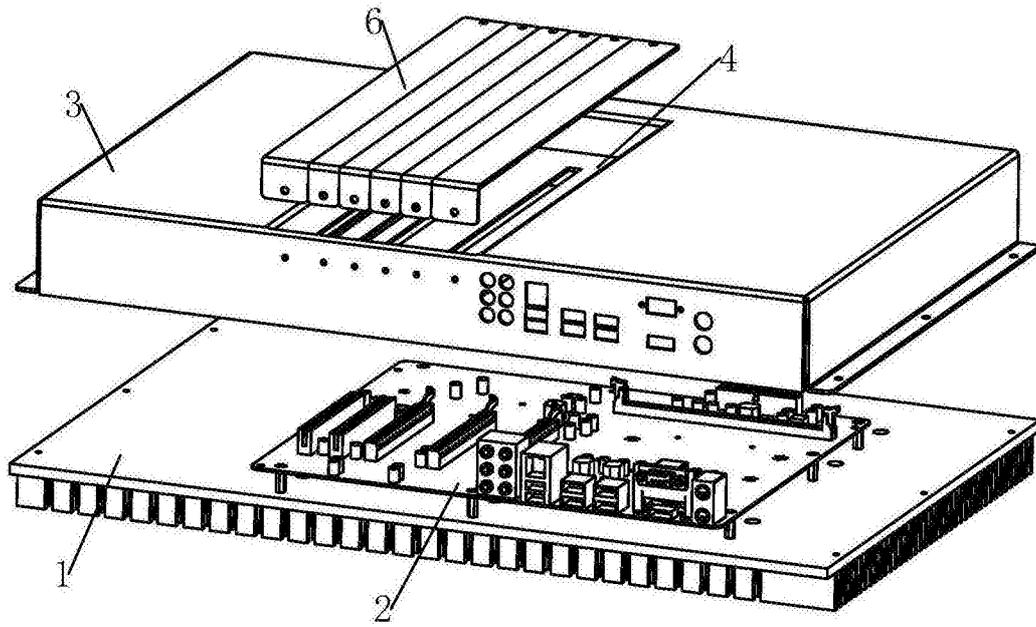


图1

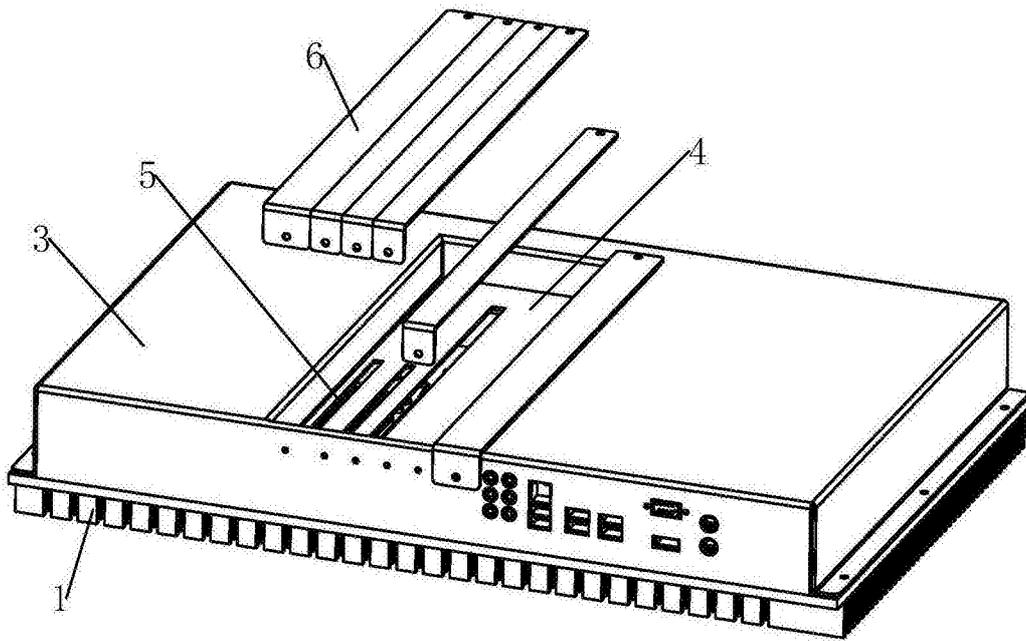


图2

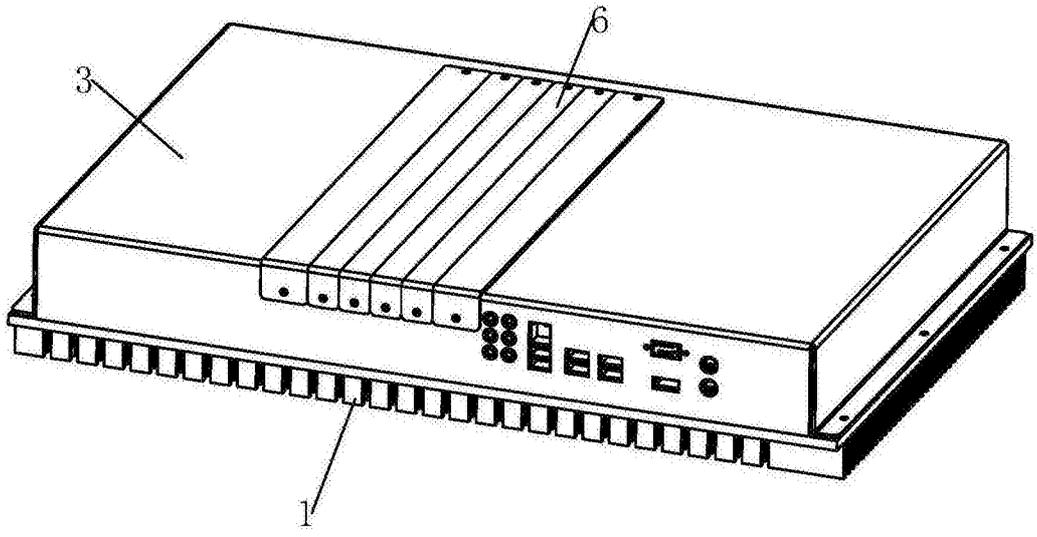


图3

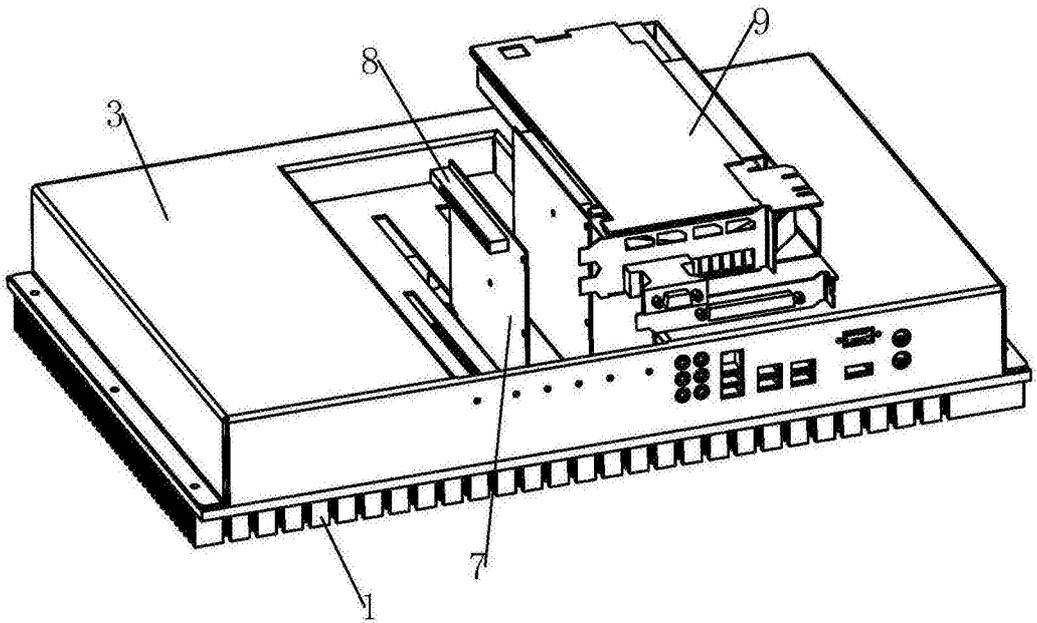


图4